



电镀要求:

1. 端子表面先电镀镍底层1-3μm,再雾锡厚3-7μm .
2. 产品须做焊锡性测试,用245° C±5° C浸锡3秒钟PIN须上锡95%
3. 产品须做溶锡性测试,产品在350° C±5° C,表面镀层在3秒内不可以脱落,发黄,发黑,起泡,堆锡
4. 产品要做锡层附着测试,产品放在265° C锡炉粘锡,冷却后,用5kg力推锡块,锡块不可以脱落或用钳子把端子扭转360° 以上,锡块不可以有脱落的现象

REV.	REVISIONS	REC.	DATE	REV.		
0	初版发行		2011.02.11			
1	产品表面增加字体		2012.02.01			
2	I尺寸由2.79±0.51改为2.70±0.51,去除表面字码		2015.05.19			

TOLERANCE:

PIN PITCH ± 0.1
ROW PITCH ± 0.3

DECIMAL. X ± 0.3
. XX ± 0.2

CHECK

黄勇

SHEET OF

REV.

A

DRAWING

宋耀林

深圳中晟磁电有限公司

Shenzhen CB Magnetics Co.,Limited

TEL

0755-61124460

MATERIAL

DAP WH9100HM

FAX

0755-61124460

PIN MATERIAL

ALLOY 42

UNIT

m/m

PART NO

DG550-8

DATE

2015-5-9